

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-008

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司（强一半导体（南通）有限公司，以下简称“南通强一”）使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由150,000.00万元增加至291,018.50万元，募集资金使用计划不变。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元，扣除发行费用人民币229,593,251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。公司及南通强一已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

二、募集资金投资项目基本情况

《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元				
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	建设主体
1	南通探针卡研发及生产项目	120,000.00	120,000.00	南通强一
2	苏州总部及研发中心建设项目	30,000.00	30,000.00	公司
	合计	150,000.00	150,000.00	

三、本次使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额及调整项目内部投资结构的原因

（一）南通探针卡研发及生产项目增加投资额及内部投资结构调整情况

在南通探针卡研发及生产项目实施过程中，公司结合下游客户需求升级、行业技术迭代以及项目实际建设情况，对原有建设方案及投资结构进行了动态复核。经审慎评估，原规划的内部投资结构已难以充分匹配当前项目实施阶段及未来产能与技术发展需求。为保障项目高标准建设及长期稳定运行，公司拟对该募投项目内部投资结构进行优化调整，在厂房建设投入和核心自动化设备投入两个方面均相应增加投资，具体原因如下：

（1）客户需求升级推动生产环境与制造体系同步提升

随着高端存储、算力芯片等领域对测试精度和可靠性要求不断提高，下游客户对探针卡产品在一致性、稳定性、批量交付能力及可追溯性等方面提出了更高标准。相应地，客户对生产制造环节的自动化水平、生产过程稳定性及质量控制能力提出了明确要求。

在项目推进过程中，公司结合客户最新技术规范和验厂要求，对整体制造体系进行了系统评估，认为仅依赖原规划的人工及半自动生产模式，已难以满足未来高端产品规模化交付需求，亟需在制造模式层面进行升级。

（2）生产线由半自动向全自动升级，显著推高设备投入强度

基于对产品品质稳定性、生产一致性及运营效率的综合考量，公司在项目实施过程中，对原规划的手动及半自动生产线方案进行了系统性升级，拟建设以全自动化生产设备为核心的先进制造体系。

相较原半自动设备，全自动探针卡制造机台在精度控制、稳定性、集成度及

信息化水平等方面均显著提升，但对应的设备单价、系统集成成本及配套调试投入也明显增加。同时，为匹配全自动生产线连续运行及高效流转需求，公司同步引入 AMHS 天车系统、AMR 智能物流系统等自动化物料搬运设施，用于实现晶圆、载具及关键工序间的无人化流转。上述自动化设备及系统的投资规模显著高于原规划的半自动机台方案，客观上推高了项目设备投资需求。

（3）自动化升级对厂房结构与配套条件提出更高要求

全自动生产线及智能物流系统的引入，对厂房在空间布局、层高承载、结构强度、电力容量、洁净环境、信息化接口及安全冗余设计等方面提出了更高要求。为保障自动化设备稳定运行及系统集成效果，公司需在原有规划基础上，对厂房结构、机电系统及相关配套进行同步强化建设。

因此，本次内部投资结构调整不仅体现为设备投入增加，也体现在厂房建设及配套工程投入的相应提升，二者相互匹配、协同实施，属于项目整体制造能力升级的必要组成部分。

（4）坚持高标准建设，提升长期投资效率与项目综合回报

探针卡产品属于高端芯片测试关键部件，其性能稳定性与一致性高度依赖制造体系的整体水平。公司坚持“高标准建设、一次性到位”的原则，在项目建设阶段即同步匹配未来产品升级及产能扩展需求，避免因初期投入不足而在后续运营阶段频繁进行技术改造或重复投资。

通过本次在厂房及自动化设备两方面同步增加投入，并对项目内部投资结构进行优化，有利于从项目全生命周期角度提升建设质量、运行效率及投资回报的稳定性。

（二）苏州总部及研发中心建设项目增加投资额及内部投资结构调整情况

结合公司项目研发的实际情况与战略发展需求，对部分研发材料或产品课题进行了调整，具体如下：

调整前的课题	调整后的课题
45μm Fine Pitch 2D MEMS 垂直探针卡的研究 与开发	垂直 MEMS 探针卡性能提升研究
超多针数 2D MEMS 探针卡的研究与开发	
50μm Pitch DRAM 探针卡的研究与开发 陶瓷封装基板的研究与开发 陶瓷卡盘的研究与开发	超高针数、超小 pitch 2.5D MEMS 探针卡的 开发 用于存储探针卡的 12inch 空间转接陶瓷基 板产品开发

贵金属电镀液的研究与开发	高价值贵金属电镀液开发
用于 Space Transformer 的玻璃基板的研究与 开发	
Micro LED Probe Unit 的研究与开发	多通道薄膜探针卡研究及针卡性能提升 (新增)
	MEMS-CIS 探针卡产品开发 (新增)
	用于 ST 的 CTE 可调 LTCC 生瓷片及配套银 浆开发 (新增)

在苏州总部及研发中心建设项目实施过程中，公司结合行业技术发展趋势、客户需求变化以及募投项目实施的实际情况，对原规划的研发方向和项目内容进行了系统性复核与论证。基于研发资源配置效率、技术路线成熟度及与公司主营业务的协同性等因素，公司对部分原规划研发项目进行了整合、合并或取消，并相对应对项目内部投资结构进行优化调整。上述调整主要基于以下原因：

（1）部分原规划项目与公司当前技术主线的协同性不足

原项目规划中包含 Micro LED Probe Unit、陶瓷卡盘等研发方向，该等项目在技术路径和应用场景上具有一定前瞻性，但与公司当前以探针卡为核心主业的技术主线相比，存在以下客观情况：

- 技术应用场景相对分散，与探针卡核心产品的直接协同程度有限；
- 研发周期较长、工程化和量产导入不确定性较高；
- 短期内难以形成对公司主营业务的直接支撑。

在项目实施论证过程中，公司认为继续同步推进上述方向，可能分散苏州总部有限的研发资源，降低整体研发投入效率。因此，经审慎评估后，公司决定取消相关项目，将苏州总部研发资源集中于与探针卡主业关联度更高、工程化路径更清晰的方向。

（2）部分研发方向被更高层级或更系统性的项目所覆盖和替代

在本次调整中，原规划中的部分研发项目并非简单终止，而是被更高技术目标、更系统性的平台项目所吸收或覆盖，例如：

原“45 μ m Fine Pitch 2D MEMS 垂直探针卡的研究与开发”，调整并整合为“垂直 MEMS 探针卡性能提升研究”，研发重点由单一 Pitch 指标转向高 Pin Count、大面积植针和长期稳定性等更具工程价值的方向；

原“50 μ m Pitch DRAM 探针卡的研究与开发”，调整升级为“超高针数、

超小 Pitch 2.5D MEMS 探针卡的开发”，以更好匹配未来 DRAM/HBM 测试需求；

原“陶瓷封装基板的研究与开发”，调整为“用于存储探针卡的 12inch 空间转接陶瓷基板产品开发”，研发方向更加聚焦于探针卡系统关键部件。

上述调整体现的是研发目标从单点技术验证向系统性、平台化能力建设演进，并未削弱研发投入，而是通过项目整合提升研发工作的系统性和聚焦度。

（3）部分项目在当前阶段技术成熟度与实施条件不足

原规划中的个别研发项目（如玻璃基板相关项目）在当前阶段仍处于技术路径尚未完全收敛、关键工艺窗口不明确的状态，研发投入强度高、验证周期长，对苏州总部及研发中心资源形成较大占用。

结合公司当前研发重点和阶段性目标，公司认为在现阶段优先推进与探针卡主业紧密相关、具备明确工程化路径和市场需求的项目，更有利于提升研发成果转化效率。因此，对上述技术成熟度不足、短期内难以形成稳定成果的项目予以取消或暂缓推进。

（4）研发资源向核心技术与关键材料方向集中配置

在本次调整后，研发资源将重点投向以下方向：

- 垂直 MEMS 探针卡在高 Pin Count、小 Pitch、大植针面积等技术方向的性能提升；
- 面向 DRAM/HBM 的超高针数 MEMS 探针卡技术；
- 多通道薄膜探针卡及高速测试能力提升；
- MEMS-CIS 探针卡的工程化与量产导入；
- 探针卡关键原材料及核心部件（贵金属电镀液、LTCC 生瓷片、银浆、空间转接基板等）的协同研发。

上述方向与公司主营业务高度一致，技术路径清晰，具备较强的工程化和产业化基础，有利于提升苏州总部及研发中心整体研发效率和投入产出比。

四、本次增加募投项目投资额及调整项目内部投资结构基本情况

（一）南通探针卡研发及生产项目

单位：万元

项目名	具体安排	本次调整前	以自有资	本次调整后
-----	------	-------	------	-------

项 称	投资总额	拟使用募 集资金金 额	金或自筹 资金追加 投资额度	投资总额	拟使用募 集资金金 额
南通探 针卡研 发及生 产项目	土地投资	2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00
	建设投资	35,404.00	35,404.00	4,077.00	39,481.00
	设备投资	65,861.00	65,861.00	116,693.00	182,554.00
	预备费	5,100.00	5,100.00	6,000.00	11,100.00
	铺底流动资金	11,400.00	11,400.00		11,400.00
	总投资金额	120,000.00	120,000.00	126,770.00	246,770.00

(二) 苏州总部及研发中心建设项目

单位：万元

项目名 称	具体安排	本次调整前		以自有资 金或自筹 资金追加 投资额度	本次调整后	
		投资总额	拟使用募 集资金金 额		投资总额	拟使用募 集资金金 额
苏州总 部及研 发中心 建设项 目	场地租赁投资	1,656.00	1,656.00		1,656.00	1,656.00
	场地装修投资	2,457.00	2,457.00		2,457.00	2,457.00
	设备投资	12,063.50	12,063.50		12,063.50	12,063.50
	软件投资	453.00	453.00	450.00	903.00	453.00
	预备费	831.00	831.00	23.00	854.00	831.00
	研发费用	12,539.50	12,539.50	13,775.50	26,315.00	12,539.50
总投资金额		30,000.00	30,000.00	14,248.50	44,248.50	30,000.00

五、本次增加募投项目投资额及调整项目内部投资结构对公司的影响

公司本次增加募投项目投资额及调整项目内部投资结构是结合下游客户需求升级、行业技术迭代、项目实际建设情况、研发资源配置效率、技术路线成熟度及与公司主营业务的协同性等因素作出的审慎决定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，进一步提高公司的核心竞争力。

本次增加募投项目投资额及调整项目内部投资结构未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整南通探针卡研发及生产项目和苏州总部及研发中心建设项目的内部投资结构，项目投资总额将由 150,000.00 万元增加至 291,018.50 万元。上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）保荐人核查意见

保荐人认为：公司本次使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额及调整项目内部投资结构已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度及调整项目内部投资结构，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额及调整项目内部投资结构事项无异议。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日